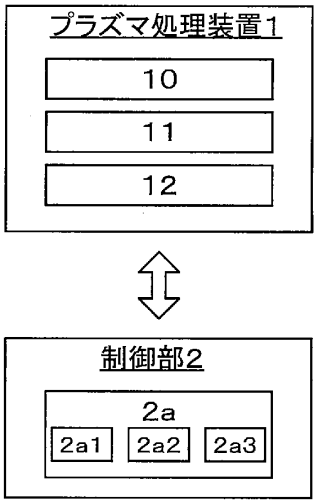
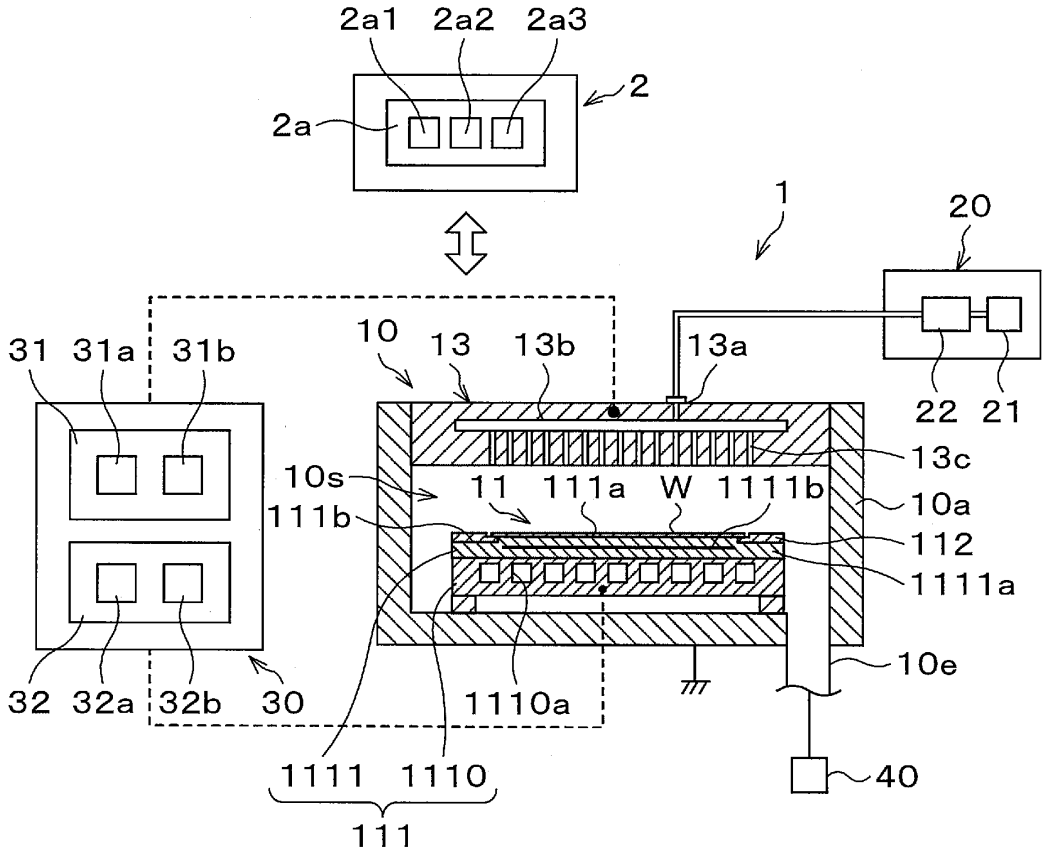
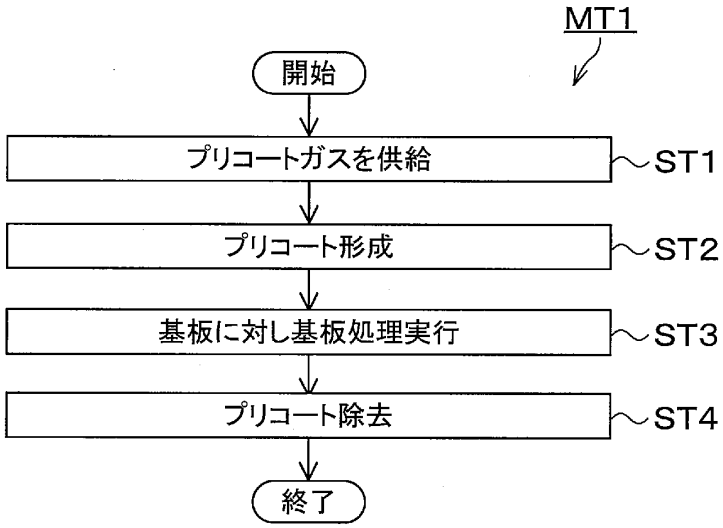
[図1]


プラズマ処理装置1
10
11
12
制御部2
2a
2a1
2a2
2a3

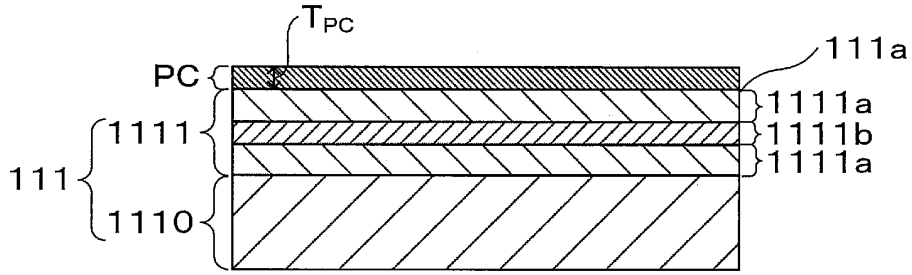
[図2]


2a1
2a2
2a3
2
2a
1
20
31
31a
31b
10
13
13b
13a
22
21
13c
10s
11
111a
W
1111b
111b
10a
112
1111a
32
32a
32b
30
1110a
10e
1111
1110
111
40

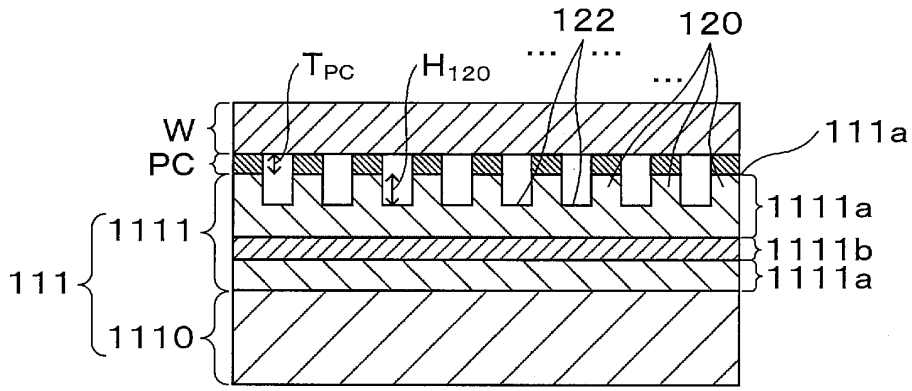
[図3]


MT1
開始
プリコートガスを供給
ST1
プリコート形成
ST2
基板に対し基板処理実行
ST3
プリコート除去
ST4
終了

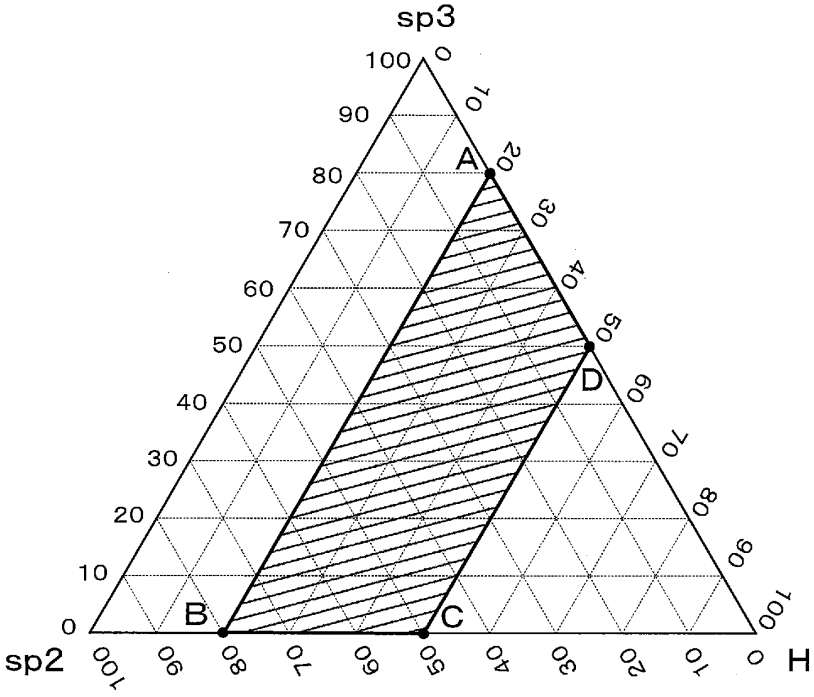
[図4]


T_{PC}
PC
111
1111
1110
111a
1111a
1111b
1111a

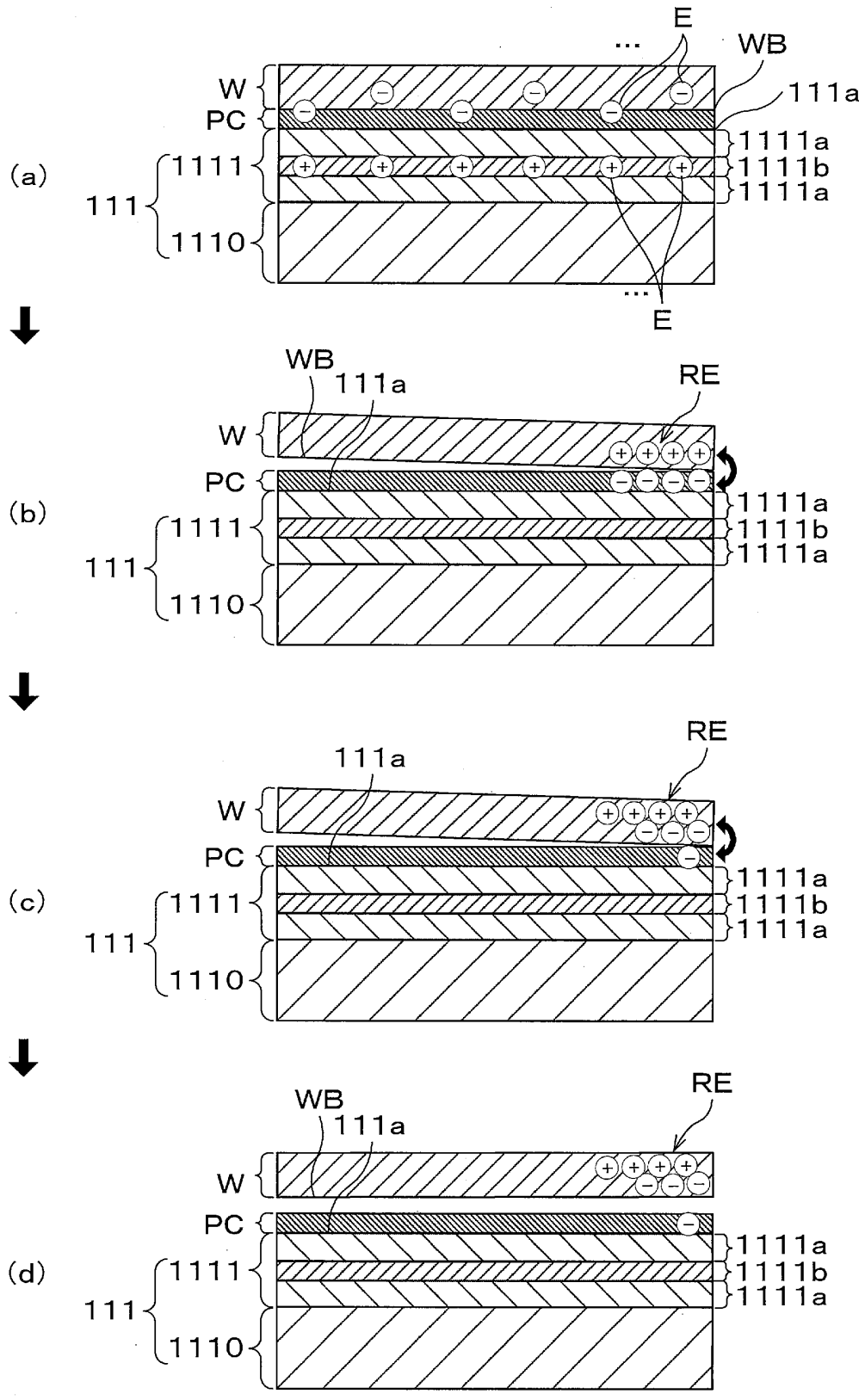
[図5]


122
120
T_{PC}
H_{120}
W
PC
111
1111
1110
111a
1111a
1111b
1111a

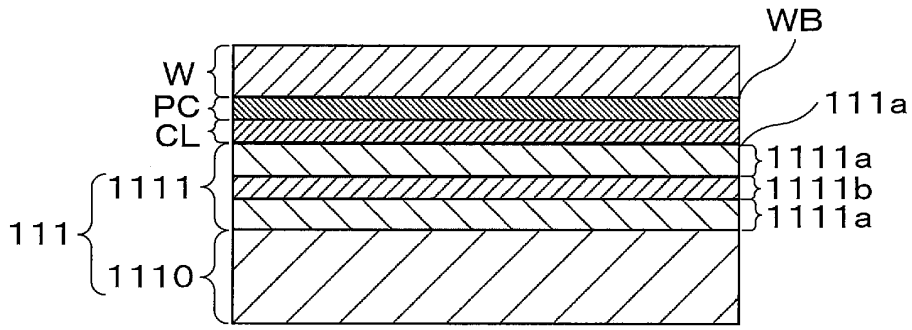
[図6]



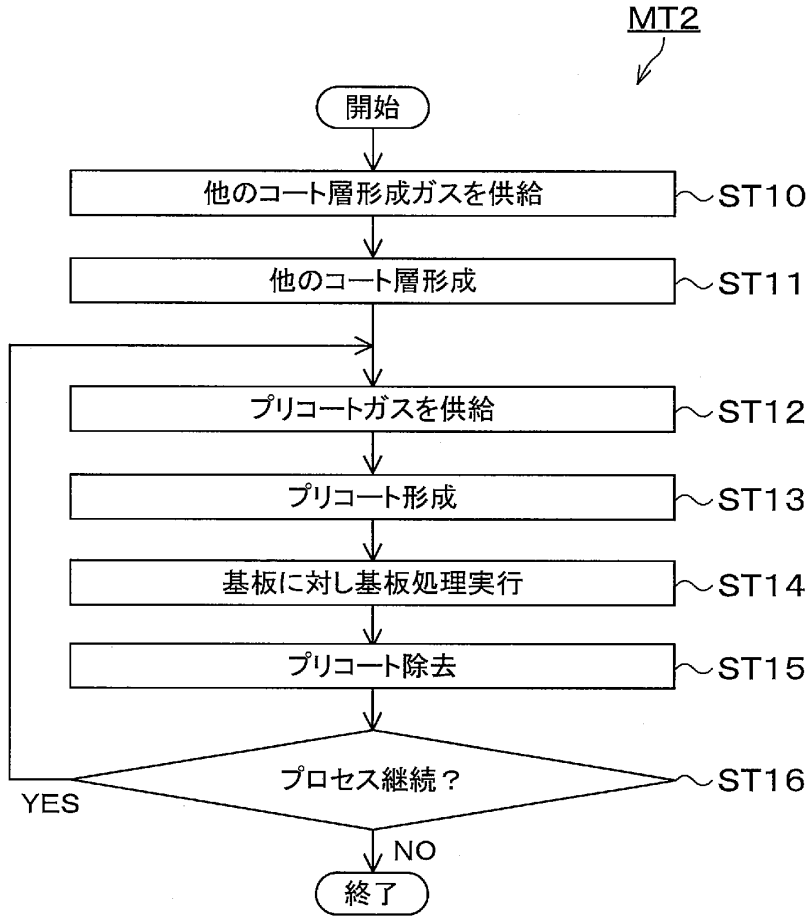
[図7]


E
WB
W
111a
PC
1111a
(a)
1111
1111b
111
1111a
1110
E
WB
111a
RE
W
PC
1111a
(b)
1111
1111b
111
1111a
1110
RE
111a
W
PC
1111a
(c)
1111
1111b
111
1111a
1110
RE
WB
111a
W
PC
1111a
(d)
1111
1111b
111
1111a
1110

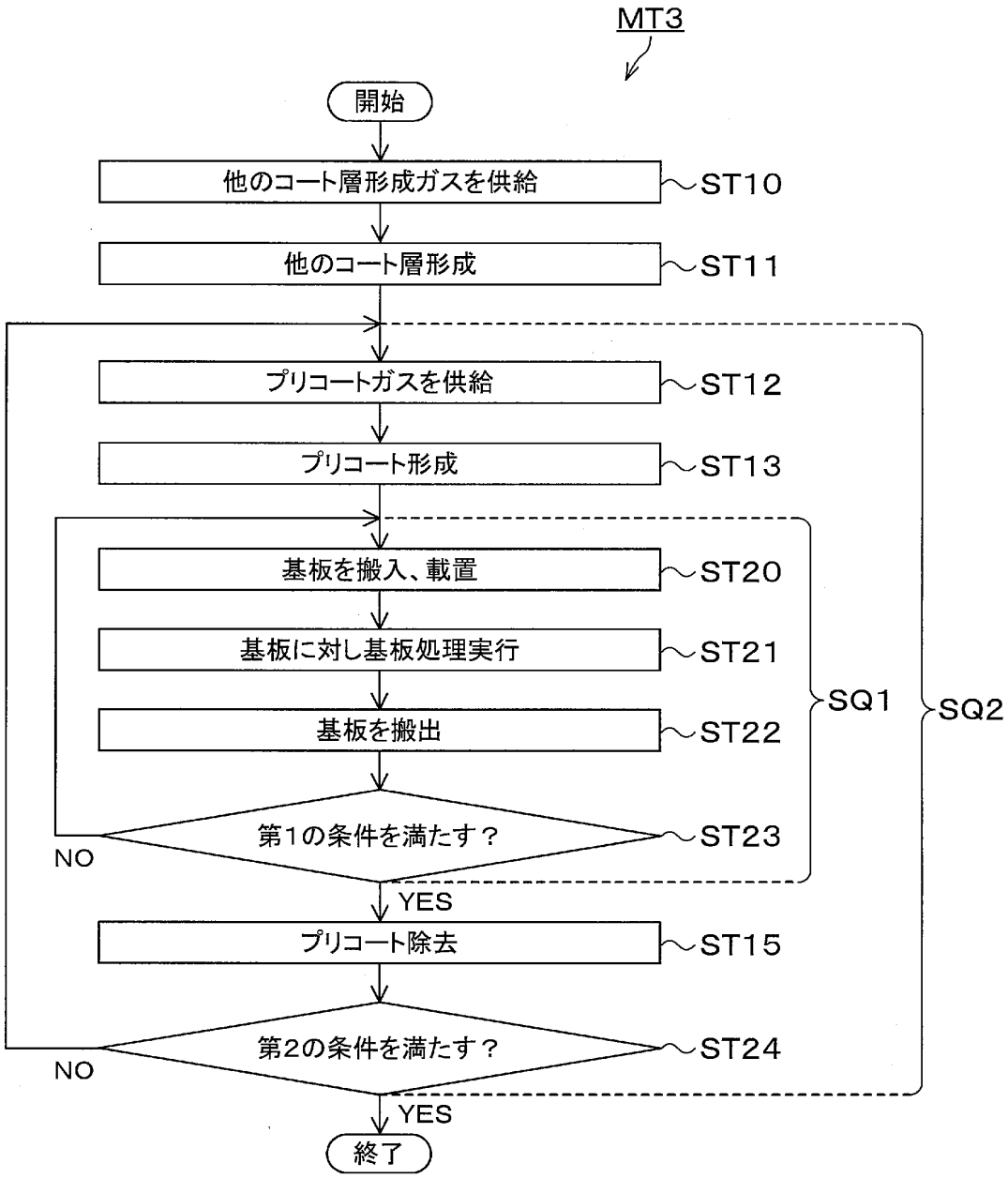
[図8]


WB
W
PC
CL
111a
1111a
1111b
1111a
1111
111
1110

[図9]


MT2
開始
他のコート層形成ガスを供給
ST10
他のコート層形成
ST11
プリコートガスを供給
ST12
プリコート形成
ST13
基板に対し基板処理実行
ST14
プリコート除去
ST15
プロセス継続？
ST16
YES
NO
終了

[図10]


MT3
開始
他のコート層形成ガスを供給
ST10
他のコート層形成
ST11
プリコートガスを供給
ST12
プリコート形成
ST13
基板を搬入、載置
ST20
基板に対し基板処理実行
ST21
基板を搬出
ST22
第1の条件を満たす？
ST23
NO
YES
プリコート除去
ST15
第2の条件を満たす？
ST24
NO
YES
終了
SQ1
SQ2